证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-039

北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2019年6月25日以电话、电子邮件方式发出。会议于2019年7月5日召开,应到监事3名,实到3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。

本次会议通过决议如下:

一、逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司拟对本次非公开发行股票的认购对象、发行数量、募集资金金额及用途进行调整,调整后的情况如下所示:

1、发行对象及认购方式

本次发行对象为北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)、国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)(以下简称“京国瑞基金”)共3名符合中国证监会规定的特定对象,发行对象全部以现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张劲松、张建辉、杨征帆回避表决。

2、发行数量

本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定,计算公式为:本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过2,000,000,000.00元,其中,国家集成电路基金认购金额为910,891,089.11元、北京电控认购金额为594,059,405.94元、京国瑞基金认购金额为495,049,504.95元。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%,截至第六届董事会第二十二次会议召开之日,上市公司总股本为458,004,372股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过91,600,874股(含本数)。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间,上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项,本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内,最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的,则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减,但最高不超过2,000,000,000.00元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张劲松、张建辉、杨征帆回避表决。

3、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过200,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
高端集成电路装备研发及产业化项目	200,508.00	178,000.00
高精密电子元器件产业化基地扩产项目	24,196.00	22,000.00
合计	224,704.00	200,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张劲松、张建辉、杨征帆回避表决。

《关于调整非公开发行股票方案的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张劲松、张建辉、杨征帆回避表决。

三、审议并通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》

同意公司与原认购对象北京电控、国家集成电路基金、京国瑞基金签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张劲松、张建辉、杨征帆回避表决。

《关于与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议及终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》

同意公司与原认购对象北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张劲松、张建辉、杨征帆回避表决。

《关于与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议及终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《关于(公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000.00万元,扣除发行费用后全部用于“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”的建设。公司组织有关部门对投资项目进行了深入的可行性研究,根据相关规定编制了《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张劲松、张建辉、杨征帆回避表决。

《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《关于(公司前次募集资金使用情况报告)的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),公司编写了《北方华创科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张劲松、张建辉、杨征帆回避表决。

《北方华创科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过了《关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施(修订稿)的议案》

为保障中小投资者的利益,公司就2019年度非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,拟定了本次非公开发行对即期收益的摊薄情况及填补回报措施,同时相关承诺主体出具了承诺。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张劲松、张建辉、杨征帆回避表决。

《北方华创科技集团股份有限公司关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施(修订稿)的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过了《关于调整公司2019年度申请综合授信额度的议案》

同意调整后的公司2019年度申请综合授信额度。本次调整后,公司2019年度申请的授信额度仍为总计不超过人民币55.65亿元。具体内容详见附件一。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议并通过了《关于调整对子公司担保的议案》

同意公司下属公司北京北方华创微电子装备有限公司(简称“北方华创微电子”)、北京晨晶电子有限公司(简称“晨晶电子”)、北京七一八友晟电子有限责任公司(简称“七一八友晟”)、北京七一八友益电子有限责任公司(简称“七一八友益”)、北京飞行博达电子有限公司(简称“博达电子”)、北京七星华创微波电子技术有限责任公司(简称“七星微电子”)、北京七星华创微波电子技术有限公司(简称“七星微波”)、北京北方华创新源理电装备技术有限公司(简称“北方华创新能源”)向北京农商银行申请集团综合授信业务时,北方华创提供保证担保授信额度合计由不超过2亿元调整为不超过1.5亿元。

1、额度有效期:1年

2、额度类别:额度可混用,可循环使用

3、担保方式:北方华创为信用担保;北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创新能源使用授信由北方华创提供保证担保。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议并通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2019年第二次临时股东大会,关于召开公司2019年第二次临时股东大会的具体时间,公司董事会将另行通知。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会
2019年7月5日

附件一:

公司分别于第六届董事会第二十次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》同意公司2019年度申请的授信额度总计不超过人民币55.65亿元,最终以各家银行及公司实际审批的授信额度为准。

为进一步满足公司生产经营及日常运作的资金需求,公司拟对原授信额度做如下调整:

调整前:

一、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行:

申请集团综合授信业务,授信额度人民币0.97亿元,其中,北方华创授信额度0.25亿元,北京晨晶电子有限公司(简称:晨晶电子)、北京七一八友晟电子有限责任公司(简称:七一八友晟)、北京七星华创微电子有限责任公司(简称:七星微电子)、北京七星华创微波电子技术有限公司(简称:七星微波)、北京七星华创电子技术有限公司(简称:七星微电子)、北京七星华创成果电路装备有限公司(简称:七星成果)授信额度合计不超过0.72亿元。

1、额度有效期:1年

2、额度类别:额度可混用,可循环使用

3、担保方式:北方华创为信用;晨晶电子、七一八友晟、七星微电子、七星微波、七星成果授用授信额度时由北方华创提供保证担保。

二、北京农商银行:

申请集团综合授信业务,授信额度人民币3亿元。其中,北方华创授信额度1亿元,北京北方华创微电子装备有限公司(简称:北方华创微电子)、晨晶电子、北京七一八友晟电子有限公司(简称:七一八友晟)、北京飞行博达电子有限公司(简称:博达电子)、七星微电子、七星微波、北京北方华创新能源理电装备技术有限公司(简称:北方华创新能源)授信额度合计不超过2亿元。

1、授信额度有效期:1年

2、额度类别:额度可混用,可循环使用

3、担保方式:北方华创为信用;北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

三、招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行:

(一)申请集团综合授信业务,授信额度人民币11亿元。其中,北方华创授信额度11亿元。

1、额度有效期:1年

2、额度类别:额度可混用,可循环使用

3、担保方式:北方华创为信用。

(二)北方华创同意北方华创微电子申请综合授信业务,授信额度人民币1.5亿元。

1、授信额度有效期:1年

2、额度类别:额度可混用(不占用北方华创授信额度),可循环使用

3、担保方式:北方华创微电子为信用担保。

调整后:

一、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行:

申请集团综合授信业务,授信额度人民币6.97亿元。其中,北方华创授信额度6.25亿元,晨晶电子、七一八友益、七星微电子、七星微波、七星成果授信额度合计不超过0.72亿元。

1、额度有效期:1年

2、额度类别:额度可混用,可循环使用

3、担保方式:北方华创为信用;晨晶电子、七一八友益、七星微电子、七星微波、七星成果授用授信额度时由北方华创提供保证担保。

二、北京农商银行:

申请集团综合授信业务,授信额度人民币2.5亿元。其中,北方华创授信额度1亿元,北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

三、招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行:

(一)申请集团综合授信业务,授信额度人民币5亿元。其中,北方华创授信额度5亿元。

1、额度有效期:1年

2、额度类别:额度可混用,可循环使用

3、担保方式:北方华创为信用。

(二)北方华创同意北方华创微电子申请综合授信业务,授信额度人民币1亿元。

1、授信额度有效期:1年

2、额度类别:额度可混用(不占用北方华创授信额度),可循环使用

3、担保方式:北方华创微电子为信用。

四、广发银行股份有限公司北京潘家园支行:

申请集团综合授信业务,授信额度人民币1亿元。其中,北方华创授信额度1亿元。

1、授信额度有效期:1年

2、额度类别:额度可混用,可循环使用

3、担保方式:北方华创为信用。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。

除此之外,公司其他申请综合授信额度不变,本次调整后,2019年度公司申请的授信额度总计不超过人民币55.65亿元,具体明细情况如下:

序号	银行名称	原授信额度(亿元)	调整额度(亿元)	调整后额度(亿元)	授信额度有效期
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行	0.97	+6	6.97	1年
2	中国建设银行股份有限公司北京光华支行	5.2			1年
3	交通银行股份有限公司北京望京支行	0.57			1年
4	中信银行总行营业部	2.7			1年
5	华夏银行股份有限公司	0.85			1年
6	北京农商银行	3	-0.5	2.5	1年
7	平安银行股份有限公司北京分行	1.1			1年
8	招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行	12.5	-6.5	6	1年
9	中国民生银行股份有限公司北京分行	4			北方华创、晨晶电子、七一八友晟、七星微电子2年;北方华创微电子1年
10	北京银行	3.26			2年
11	中国工商银行	4.5			1年
12	中国农业银行	6			不超过3年
13	中国进出口银行北京分行	7			不超过3年
14	国家开发银行北京分行	4			不超过10年
15	广发银行股份有限公司北京潘家园支行	0	+1	1	1年
	合计	55.65	0	55.65	

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-040

北方华创科技集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2019年6月25日以电话、电子邮件方式发出。会议于2019年7月5日上午如期在公司会议室以现场方式召开,应到监事3名,实到3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。

本次会议通过决议如下:

一、逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司拟对本次非公开发行股票的认购对象、发行数量、募集资金金额及用途进行调整,调整后的情况如下所示:

1、发行对象及认购方式

本次发行对象为北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)、国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)(以下简称“京国瑞基金”)共3名符合中国证监会规定的特定对象,发行对象全部以现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2、发行数量

本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定,计算公式为:本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过2,000,000,000.00元,其中,国家集成电路基金认购金额为910,891,089.11元、北京电控认购金额为594,059,405.94元、京国瑞基金认购金额为495,049,504.95元。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%,截至第六届董事会第二十二次会议召开之日,上市公司总股本为458,004,372股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过91,600,874股(含本数)。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间,上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项,本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内,最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的,则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减,但最高不超过2,000,000,000.00元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过200,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
高端集成电路装备研发及产业化项目	200,508.00	178,000.00
高精密电子元器件产业化基地扩产项目	24,196.00	22,000.00
合计	224,704.00	200,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》

同意公司与原认购对象北京电控、国家集成电路基金、京国瑞基金签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

《关于与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议及终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》

同意公司与原认购对象北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

《关于与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议及终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于(公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000.00万元,扣除发行费用后全部用于“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”的建设。公司组织有关部门对投资项目进行了深入的可行性研究,根据相关规定编制了《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于(公司前次募集资金使用情况)报告》的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),公编写了《北方华创科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过了《关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施(修订稿)的议案》

为保障中小投资者的利益,公司就2019年度非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,拟定了本次非公开发行对即期收益的摊薄情况及填补回报措施,同时相关承诺主体出具了承诺。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司监事会
2019年7月5日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-041

北方华创科技集团股份有限公司关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”、“公司”)就本次2019年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

(一)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行拟募集资金总额不超过200,000.00万元,发行股票数量依据募集资金总额和发行价格确定,且不超过本次非公开发行前总股本的20%,截至第六届董事会第二十二次会议召开之日,上市公司总股本为458,004,372股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过91,600,874股(含本数)。本次发行完成后公司的总股本和归属于母公司股东权益将有所增加。根据测算,本次非公开发行完成后,因募投项目的效益实现需要一定的时间,因此预计短期内公司每股收益将会出现一定程度的摊薄。为了充分保障投资者的利益,公司按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》对每股收益摊薄情形的要求,对本次融资的必要性、合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目的储备情况以及公司填补回报的具体措施进行分析以及作出相关承诺。

1、本次非公开发行对公司每股收益影响的假设前提

(1)假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

(2)在预测公司总股本时,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素所导致的股本变化。截至第六届董事会第二十二次会议召开之日,上市公司总股本为458,004,372股,本次非公开发行股票数量上限为91,600,874股,按照本次非公开发行股票的数量上限计算,本次非公开发行完成后,公司总股本将达到549,605,246股;

(3)假设本次非公开发行于2019年12月完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响,最终以经中国证券监督委员会核准并实际发行完成时间为准;

(4)公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为7,631.72万元。假设公司2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上一年度保持持平或每年增长25%。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策;

(5)假设2019年度、2020年度未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响,不进行利润分配;

(6)本次发行对即期回报的影响测算,暂不考虑股权激励计划、募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。

2、本次非公开对扣除非经常性损益后的每股收益的影响测算

根据上述假设,公司测算了本次非公开发行对2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的每股收益的影响,具体情况如下:

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年12月31日/2019年度		2020年12月31日/2020年度	
		本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后
总股本(股)	458,004,372	458,004,372	549,605,246	458,004,372	549,605,246
	情景一:假设除本次募集资金投资项目外,公司2019年、2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均与2018年度持平。				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(元)	76,317,150.60	76,317,150.60	76,317,150.60	76,317,150.60	76,317,150.60
基本每股收益(元/股)	0.1666	0.1666	0.1666	0.1666	0.1389
	情景二:假设除本次募集资金投资项目外,公司2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2018年度同比增长25%。				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(元)	76,317,150.60	95,396,438.25	95,396,438.25	119,245,547.81	119,245,547.81
基本每股收益(元/股)	0.1666	0.2083	0.2083	0.2604	0.2170

注:

1、公司对2019年、2020年净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

2、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准;

3、上表中基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)进行测算,即:

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

根据测算,本次非公开发行完成后,预计短期内公司每股收益相比发行前将会出现一定程度的摊薄。

公司提醒投资者,上述分析不构成公司的盈利预测,本次发行尚需监管部门核准,能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间等均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

(二)本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过200,000.00万元,扣除发行费用后拟全部投入以下项目:

单位:万元

项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
高端集成电路装备研发及产业化项目	200,508.00	178,000.00
高精密电子元器件产业化基地扩产项目	24,196.00	22,000.00
合计	224,704.00	200,000.00

1、高端集成电路装备研发及产业化项目的必要性和合理性

(1)项目实施的必要性

①落实国家产业规划的需要

集成电路是当今信息技术产业高速发展的基础和源动力,已经高度渗透与融合到国民经济和社会发展的每个领域。我国集成电路市场自给率尚不足20%,整个电子产业的芯片需求依然严重依赖进口,2017年我国集成电路进口金额高达2,601.4亿美元,同比增长14.6%,连续多年成为第一大进口商品。加快发展集成电路产业,提升行业内企业的能力和水平已成为当务之急。

国家陆续出台了若干规划指引集成电路产业的发展方向。2016年7月,国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》。该规划要求攻克14纳米刻蚀设备、薄膜设备、掺杂设备等高端制造装备及零部件,突破28纳米浸没式光刻机及核心部件,研制300毫米硅片等关键材料,研发14纳米逻辑与存储芯片成套工艺及相应系统封测技术,开展7-5纳米关键技术研究,形成28-14纳米装备、材料、工艺、封测等较完整的产业链,整体创新能力进入世界先进行列。

2017年4月,科技部发布《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》,提出要重点围绕28-14纳米技术节点进行工艺、装备和关键材料的协同布局,形成28-14纳米装备、材料、工艺、封测等较完善的产业链,推动全产业链专项成果的规模化应用,促进产业生态的改善和技术升级,实现技术促进产业发展的目标。面向集成电路14-10纳米先进工艺,重点开展刻蚀、薄膜、化学机械处理、掺杂和检测等关键装备及其配套核心零部件产品研发,通过大生产线考核并进入销售。上述一系列支持中国集成电路产业发展的政策文件基本上都将国内的集成电路产业规划为到“十三五”末期,实现14纳米技术代的量产。

此外,不论在产业政策层面还是在商业层面看,集成电路的产业发展是一个持续的发展过程,而且国内主要的代工厂和存储器厂都已经启动了再下一技术代的器件研发。根据产业经验,一个关键技术代的器件从启动研发到量产大约需要五年时间,结合该周期以及65/7纳米设备的技术难度,有必要尽快启动65/7纳米设备的关键技术攻关,落实《“十三五”国家科技创新规划》中“开展7-5纳米关键技术研究”的战略规划。

综上,通过实施本项目以加快集成电路装备产业发展并加速核心技术研发,不仅是避免过度对外依赖、提升国家信息安全水平的保障,更是落实国家产业规划的需要。

②满足巨大的产业市场需求的需要

随着世界经济的复苏和世界半导体市场的增长,我国已经成为全球最大的电子产品制造基地,也是全球最大的半导体消费市场。中国半导体市场地位的逐年提升,国内政策与资金环境的不断改善都促使着全球产业重心一步步向中国大陆倾斜。同时,旺盛的市场需求环境下,技术与资金的加速转移也为我国集成电路产业带来了新的发展机遇。据中国半导体行业协会统计,2017年我国集成电路产业实现销售产值5,411.5亿元,同比增长24.8%。赛迪顾问预测至2020年,中国集成电路产业规模将超过9,000亿元,2017-2020年年均复合增长率高达20.8%。

各类电子消费终端的技术发展,对半导体集成电路芯片的需求越来越大。现行电子终端发展趋势主要包含手机、物联网、互联网、游戏、PC等技术的发展,未来科技发展的大趋势主要包括人工智能、机器学习、大数据、机器人和自动驾驶等技术的发展。这些大趋势的实现都需要芯片作为基础。

以台积电、格罗方德、英特尔和三星为代表的世界主要半导体制造厂商均掌握了14纳米及以下技术节点的量产工艺技术,部分公司掌握了7纳米的量产工艺技术,并持续向5纳米研发,而中国大陆厂商中芯国际,也计划在2018-2019年实现14纳米工艺量产,后续也计划开展7纳米先导工艺的研发。近年来在国家政策大力支持的背景下,中国集成电路芯片制造技术发展迅速,但整体水平较国际先进水平依然存在“两、三代”的差距。

虽然国内外半导体制造厂商的技术差距明显,但都在向更高阶技术代推进芯片工艺研发工作,从而带动上游集成电路设备产业共同进步,并催生了对国产设备的巨大市场需求。随着集成电路制造工艺向14纳米及以下技术代的深入发展,特征尺寸不断缩小,新结构、新材料不断被应用,新技术层出不穷。一代技术依赖于一代工艺,一代工艺又依赖于一代设备来实现,集成电路产业的发展依赖于装备的不断更新换代,装备是推动产业技术创新的引擎。而从产业链构成方面看,在集成电路设计、制造、封测三个主要环节,中国企业均已经初步具备了参与全球竞争的能力,因此集成电路装备的“国产化”是一个顺应市场需求的过程,未来几年也将是中国集成电路设备产业发展的“黄金时代”。

③提高公司经营实力的需要

公司作为国家02重大科技专项承担单位,通过承担重大专项多项课题的科研任务,先后完成了12吋集成电路制造设备90-28nm等多个关键制程的攻关工作,目前所承担的02专项在研课题14nm制程设备也已交付至客户端进行工艺验证。

公司本次非公开发行募投项目的实施,将在半导体领域的刻蚀机、薄膜沉积设备、热处理设备和清洗设备等几个核心设备领域打造持续的核心竞争力,持续而紧密的跟随国内、国际客户的芯片生产工艺技术代,在28纳米的基础上,进一步实现14纳米设备的产业化,开展5/7纳米设备的关键技术研发。本次非公开发行符合公司的长期战略规划,并能够为客户提供持续的设备支持和工艺服务,有助于进一步保持公司在国内集成电路设备领域的领先地位,并提升公司现有高端集成电路设备的产业化能力,实施本项目具有现实必要性。

④实现公司发展战略的需要

公司的战略愿景是要持续以客户需求为导向的进行创新,致力于成为一家值得信赖并受人尊重、在微电子装备领域拥有领先技术并具有国际影响力的高端装备及工艺解决方案提供商。在这个战略愿景的指导下,公司将在半导体领域的刻蚀机、薄膜沉积设备、热处理设备和清洗设备等几个核心设备领域打造持续的核心竞争力,紧密跟随国内、国际客户的芯片生产工艺技术代,在28纳米的基础上,进一步实现14纳米设备的产业化并开展5/7纳米设备的关键技术研发是公司实现这一战略规划的需要。

⑤建设满足要求的研发环境的需要

5/7纳米的设备的研发需要更加洁净的研发、试验和验证环境,相关的辅助动力设备和现有的洁净实验室难以满足要求,因此需要建设集成电路设备创新中心楼,并单独在集成电路设备创新中心楼中建设符合要求的研发和验证洁净厂房,此外还需要在新建的超净厂房中建设单独的测试间,用于放置5/7纳米技术代的测试设备和仪器,并在工艺设备验证期间进行硅片的工艺结果的测试。

(2)项目可行性分析

①国家产业政策的持续支持

近年来,国家对集成电路产业的发展高度重视,通过政策与金融双轮驱动的手段大力推进国内集成电路产业的发展。2014年6月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,提出要加强集成电路装备、材料与工艺结合,研发刻蚀机等关键设备,加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作,加快产业化进程,增强产业配套能力,到2020年集成电路16/14纳米制造工艺实现规模量产,基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。该纲要的推出显示了国家对于集成电路产业发展的迫切要求,对于推进中国集成电路全产业链的快速健康发展具有重要意义。2016年7月,国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》,要求攻克14纳米刻蚀设备等高端制造装备及零部件,形成28-14纳米装备、材料、工艺、封测等较完整的产业链,整体创新能力进入世界先进行列。2016年12月,国务院常务会议通过《国家科技重大专项“十三五”发展规划》,要求加快推进集成电路装备等重大专项,推动我国科技实力和竞争力整体跃升。2018年3月,政府工作报告中再一次强调要深入推进供给侧结构性改革,加快制造强国建设,推动集成电路等产业发展,由此可见,集成电路产业在众多供给侧改革所推进的实体产业中具有首要地位。上述一系列支持政策的陆续出台,对集成电路产业的装备、材料、工艺、封测等细分产业进行了科学的规划和布局,为未来产业的发展创造了良好的政策环境。

②技术优势与人才优势

公司已经具备了较强的自主创新研发能力,通过一系列研发项目的实施,打破了高端设备的国际垄断,将国内大规模集成电路高端装备的技术水平与国际主流大厂进一步拉近,实现了28纳米及以上技术代集成电路装备的量产,关键14纳米装备也已经进入验证阶段。在不断的技术和产品研发过程中,公司的集成电路设备工艺水平从100纳米、90纳米、65纳米、40纳米、28纳米发展到14纳米水平,在这个过程中公司积累和掌握了刻蚀工艺、薄膜工艺、等离子技术、精密机械、材料处理、自动化及软件、超高真空、传输技术、ESC(静电卡盘)技术等集成电路装备相关的核心技术。此外,公司在发展过程中十分重视对技术人才的培养和激励,其通过合作、交流和学习等方式为不同岗位的人员提供良好的专业技术培训,并通过股权激励的方式鼓励关键人才积极投身技术研发,与公司共同成长,成功打造了集成电路装备领域的人才高地。

③完善的配套